

RF Devices and Customer made Antenna

Product catalog

www.passivecomponent.com



Product Portfolio



Multilayer Ceramic Capacitors (MLCC)



Chip-Resistor



Disc Capacitors



RF Device and High Frequency Inductors



Antenna



Inductors



Varistors and SMD-Varistors

IEC-63 Nominal Resistance / Capacitance

E1	100																							
E3	100				220				470															
E6	100	150	220	330	470	680																		
E12	100	120	150	180	220	270	330	390	470	560	680	820												
E24	100	110	120	130	150	160	180	200	220	240	270	300	330	360	390	430	470	510	560	620	680	750	820	910
E96	100	102	121	124	147	150	178	182	215	221	261	267	316	324	383	392	464	475	562	576	681	698	825	845
	105	107	127	130	154	158	187	191	226	232	274	280	332	340	402	412	487	499	590	604	715	732	866	887
	110	113	133	137	162	165	196	200	237	243	287	294	348	357	422	432	511	523	619	634	750	768	909	931
	115	118	140	143	169	174	205	210	249	255	301	309	365	374	442	453	536	549	649	665	787	806	953	976

E6: $\sqrt[6]{10} \approx 1.46$ E12: $\sqrt[12]{10} \approx 1.21$

E1 series resistance: 1Ω, 10Ω, 100Ω, 1000Ω, 10000Ω, 100000Ω

■ CHIP ANTENNA

RF	ANT	321612	0	A	5	T
Type code	Product code	Dimension code	Unit of dimension	Application	Specification	Packing
RF/RG: device	ANT : Antenna FRA : Free Antenna ECA : SMD Antenna	Per 2 digits of Length, Width, Thickness 321612 = Length =32 Width = 16 Thickness = 12	0 : 0.1 mm 1 : 1.0 mm	A: 2.4GHz ISM Band E : GPS 1.5GHz L : 2.4/5.2/5.8GHz Tri Band W : WiMAX	Code from 0-9 dependent on different electrical specification	T: 7" Reeled G: 13" Reeled

■ HIGH FREQUENCY MULTILAYER BAND PASS FILTER

RF	BPF	322515	0	A	4	T
Type code	Product code	Dimension code	Unit of dimension	Application	Specification	Packing
RF device	BPF : Band Pass Filter	Per 2 digits of Length, Width, Thickness 322515 = Length =32 Width = 25 Thickness = 15	0 : 0.1 mm 1 : 1.0 mm	A : 2.4GHz ISM Band W : WiMAX K : ISM 5.2/5.8 Dual Band	Code from 0-9 dependent on different electrical specification	T: 7" Reeled G: 13" Reeled

■ HIGH FREQUENCY MULTILAYER BALANCED FILTER

RF	BPB	252009	0	A	7	T
Type code	Product code	Dimension code	Unit of dimension	Application	Specification	Packing
RF/RG: device	BPB : Balanced Type Band Pass Filter	Per 2 digits of Length, Width, Thickness 252009 = Length =25 Width = 20 Thickness = 09	0 : 0.1 mm 1 : 1.0 mm	A : 2.4GHz ISM Band W : WiMAX	Code from 0-9 dependent on different electrical specification	T: 7" Reeled G: 13" Reeled

■ HIGH FREQUENCY MULTILAYER LOW PASS FILTER

RF	LPF	201211	0	A	0	T
Type code	Product code	Dimension code	Unit of dimension	Application	Specification	Packing
RF device	LPF : Low Pass Filter	Per 2 digits of Length, Width, Thickness 201210 = Length =20 Width = 12 Thickness = 11	0 : 0.1 mm 1 : 1.0 mm	A : 2.4GHz ISM Band K : ISM 5.2/5.8 Dual Band	Code from 0-9 dependent on different electrical specification	T: 7" Reeled G: 13" Reeled

■ HIGH FREQUENCY MULTILAYER HIGH PASS FILTER

RF	HPF	252009	0	L	0	T
Type code	Product code	Dimension code	Unit of dimension	Application	Specification	Packing
RF device	HPF : High Pass Filter	Per 2 digits of Length, Width, Thickness 252009 = Length =2.5 Width = 2.0 Thickness = 0.9	0 : 0.1 mm 1 : 1.0 mm	L : 2.4/4.9/5.2/5.8GHz Multiband Application	Code from 0-9 dependent on different electrical specification	T: 7" Reeled G: 13" Reeled

■ BALUN TRANSFORMERS

RF	BLN	201208	0	A	4	T
Type code	Product code	Dimension code	Unit of dimension	Application	Specification	Packing
RF/RG: device	BLN : BALUN	Per 2 digits of Length, Width, Thickness 201208 = Length =20 Width = 12 Thickness = 08	0 : 0.1 mm 1 : 1.0 mm	A : 2.4GHz ISM Band K : ISM 5.2/5.8 Dual Band	Code from 0-9 dependent on different electrical specification	T: 7" Reeled G: 13" Reeled

■ ELECTRICAL SPECIFICATION

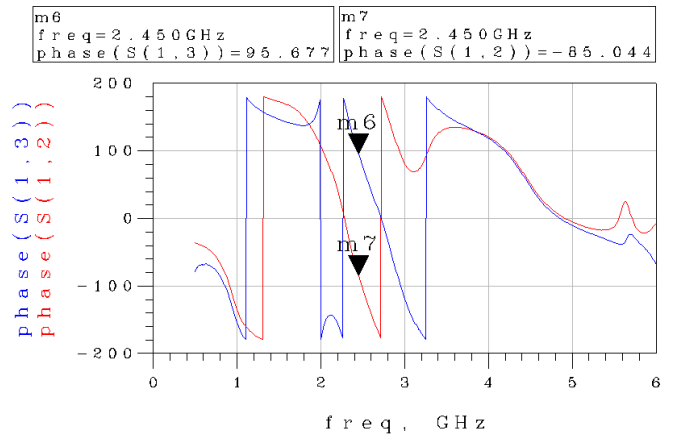
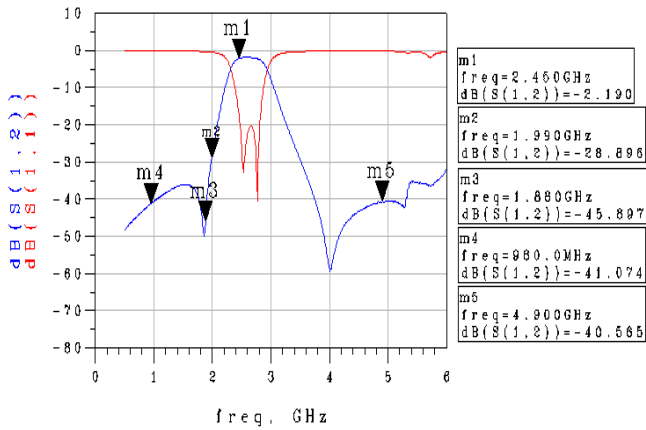
2.4GHz BAND WORKING FREQUENCY

Part Number	Frequency Range (MHz)	Impedance(Ω)		Insertion Loss (dB)	Attenuation (dB min.)	VSWR (Max.)	Phase Difference	Amplitude Difference	Size (mm)	STRUCTURE
		Unbalance	Balance							
RFBPB2012090A1T	2.4~2.5	50	Conjugate match to BC series of Bluetooth chipset	3.5	35(880~960MHz) 30(1710~1880MHz) 20(1880~1990MHz) 30(4800~5000MHz)	2.1	180°± 10	2	2.00x1.25x0.90	A-1
RFBPB2012090A9T	2.4~2.5	50	Conjugate match to BC series of Bluetooth chipset	2.8	35(880~960MHz) 30(1575MHz) 25(1710~1880MHz) 30(4800~5000MHz)	2.1	180°± 10	2	2.00x1.25x0.90	A-1
RFBPB2012090AAT	2.4~2.5	50	Conjugate match to CSR BC03/ 04 series	3.5	35(880~960 MHz) 30(1710~1880 MHz) 20(1880~1990 MHz) 30(4800~5000 MHz)	2.1	180°± 10	2	2.00x1.25x0.90	A-1
RFBPB2012060ABT	2.4~2.5	50	Impedance match to T.I. CC253X,CC254X, CC257X, CC853X and CC852X Chipsets	1.5max.(25°C) 1.7max. (-40~+85°C)	12(1000 MHz) 15(4800~5000 MHz) 20(7200~7500 MHz)	2.0	180°± 15	2	2.00x1.25x0.60	B
RFBPB2012090AHT	2.4~2.5	50	100	3.5	30(880~960MHz) 30(1710~1880MHz) 20(1880~1990MHz) 30(4800~5000MHz)	2.0	180°± 10	2	2.00x1.25x0.90	A-1
RFBPB2012090AM1T59	2.4~2.5	50	Conjunction to MT5931/MT6628 Chipset	2.5 (typ.2.2)	35(824~960 MHz) 32(1990 MHz) 18(2170 MHz) 40(4800~5000MHz) 25(7200~7500MHz)	2.0	180°± 10	2	2.00x1.25x0.95	A-1
RFBPB2012090AM1T61	2.4~2.5	50	Conjugate match to MTK MT6611 Bluetooth chipset	2.8	35(880~960MHz) 30(1710~1880MHz) 20(1880~1990MHz) 30(4800~5000MHz)	2.1	180°± 10	2	2.00x1.25x0.90	A-1
RFBPB2012100A6T	2.4~2.5	50	Conjugate match to BC series of Bluetooth chipset	3.5	35(880~960MHz) 30(1710~1880MHz) 20(1880~1990MHz) 40(4800~5000MHz)	2.0	180°± 10	2	2.00x1.25x1.00	A-1
RFBPB2012110A5T	2.4~2.5	50	50	2.8	30(880~960 MHz) 30(1710~1880 MHz) 20(1880~1990 MHz) 30(4800~5000 MHz)	2.0	180°± 10	2	2.00x1.25x1.10	A-1
RFBPB2520090A7T	2.4~2.5	50	Conjugate match to TI BRF6150	3.5	35(880~960MHz) 30(1710~1880MHz) 25(1880~1990MHz) 25(4800~5000MHz)	2.0	180°± 15	1.5	2.50x2.00x0.90	A-2

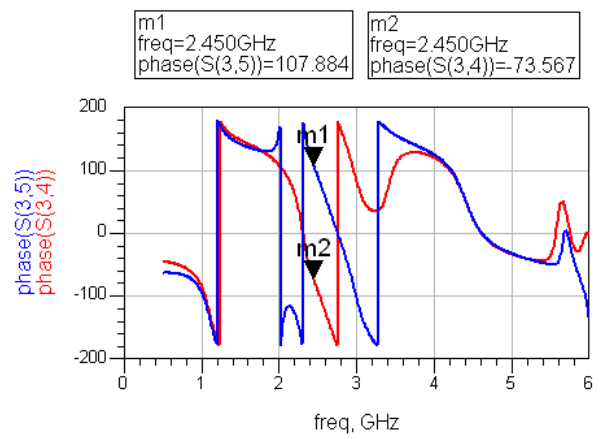
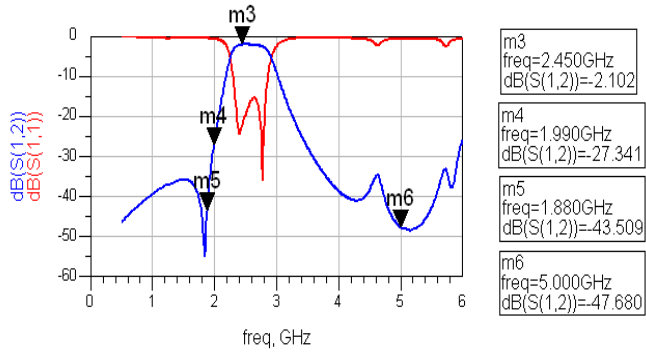
HIGH FREQUENCY MULTILAYER BALANCED FILTER

■ TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS

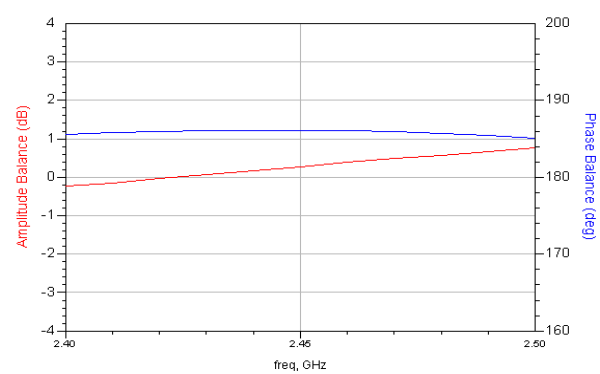
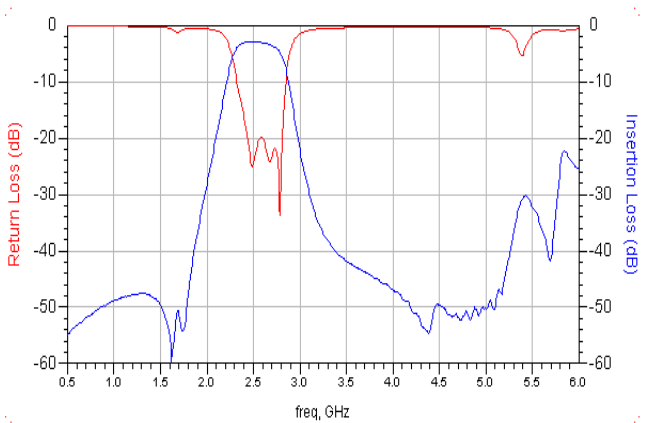
RFBPB2012090A1T



RFBPB2012090A2T



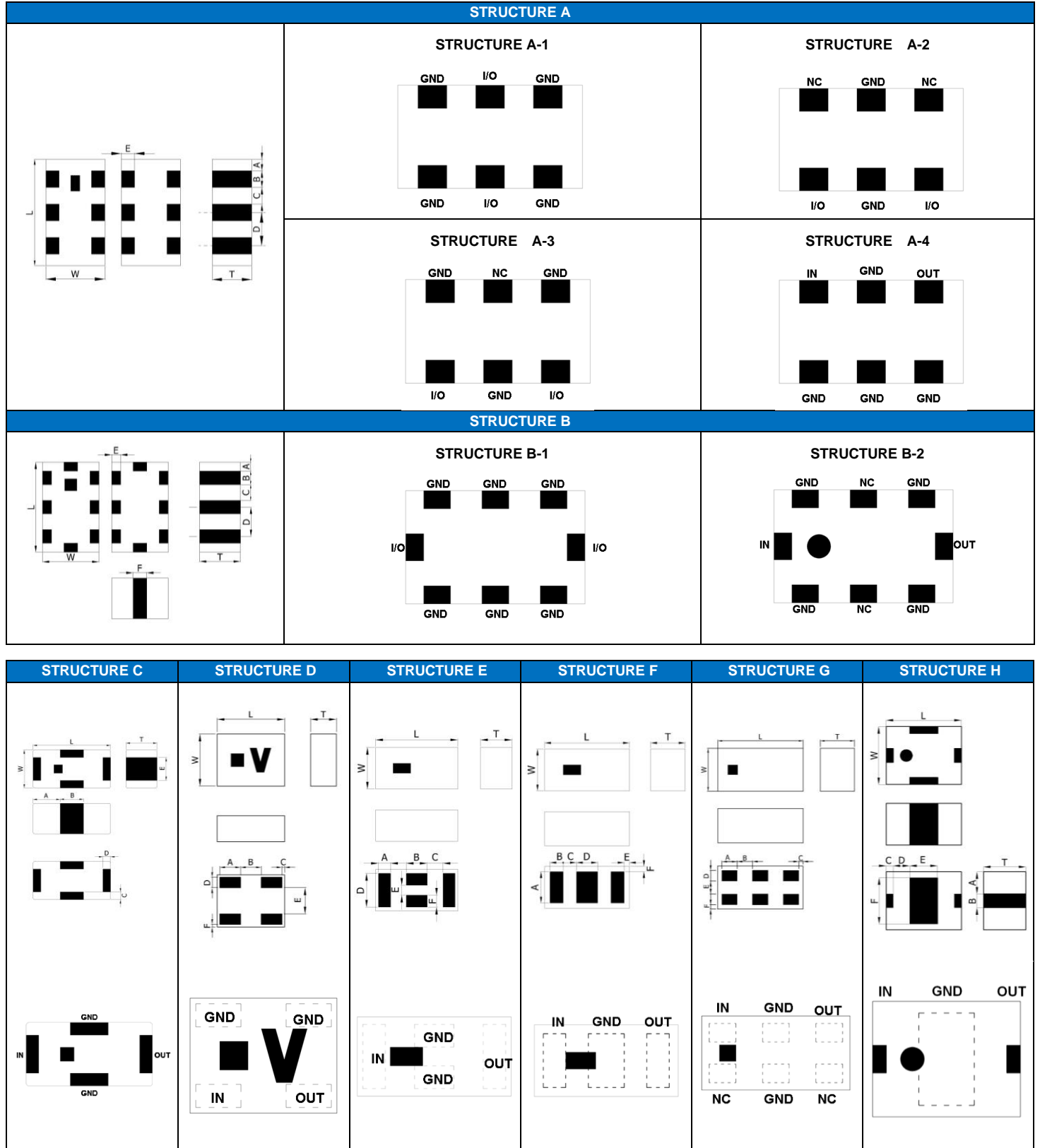
RFBPB2012100A6T



- For more information, please contact with local sales representative
- All specifications are subject to change without notice

HIGH FREQUENCY MULTILAYER LOW PASS FILTER

■ STRUCTURE AND PIN ASSOCIATED





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.